

# GoKit3介绍

高福东 20160625

**开放生态**

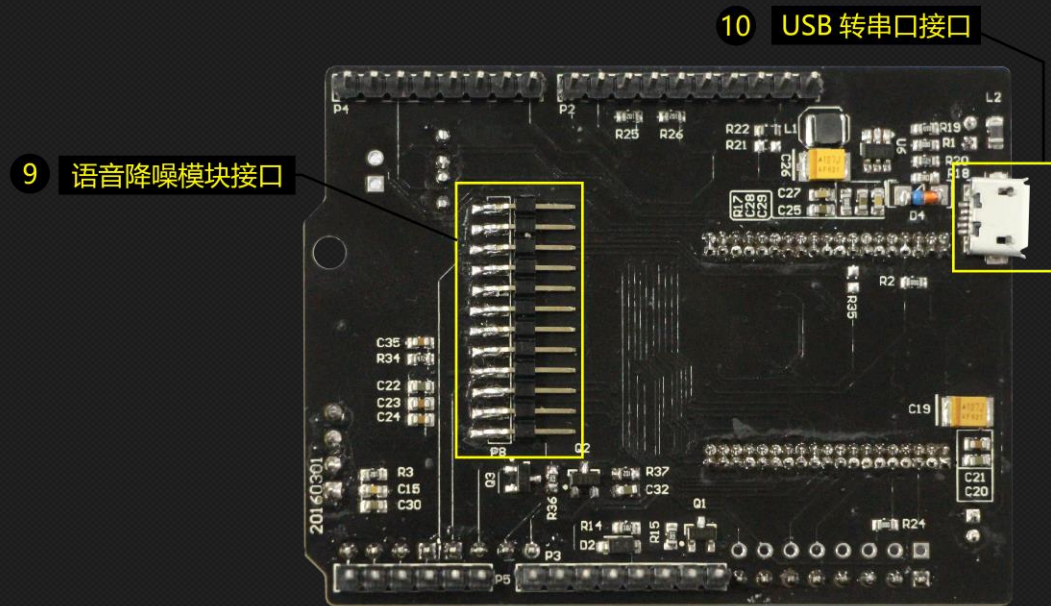
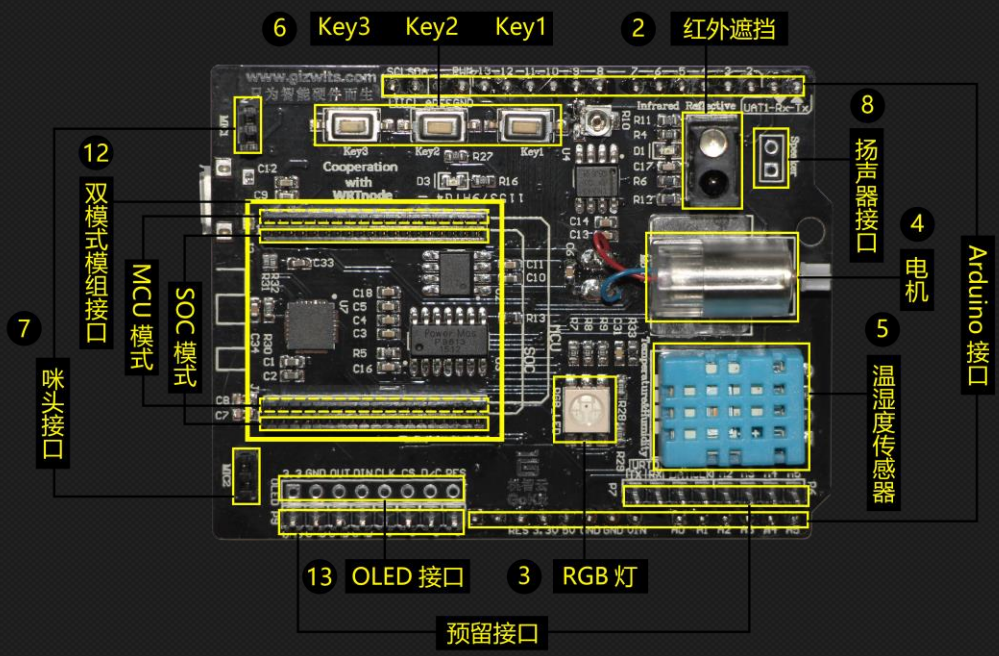
# GoKit3

GoKit3保留了GoKit2双层板的设计，采用底板+功能版+模组的方式。

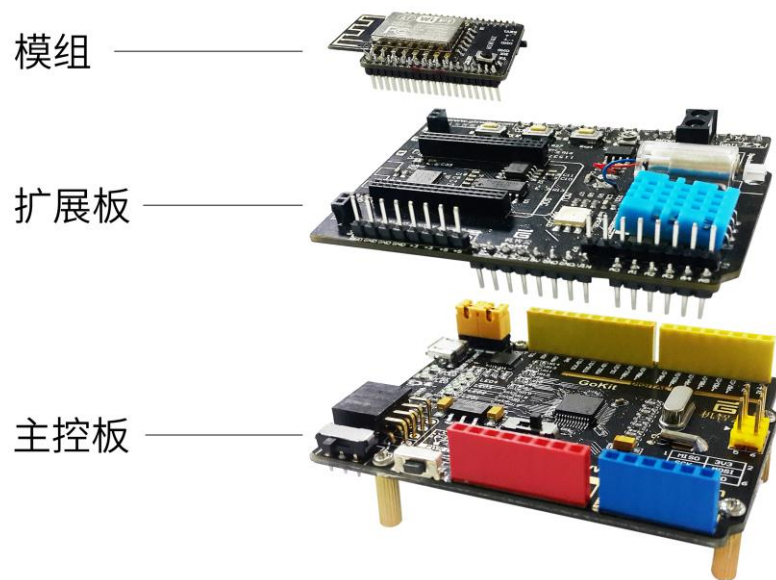
功能板特性：

- 1、独创的双排模组接口，兼容MCU和SoC两种连接方式。
- 2、1路USB转TTL调试串口。可用于SoC方式开发的日志输出。
- 3、兼容Arduino接口。
- 4、GoKit经典传感器组合，温湿度、红外感应、双向电机、RGB灯。
- 5、3个key。
- 6、增加2路MIC，1路Speaker。
- 7、丰富的扩展接口，如OLED等。

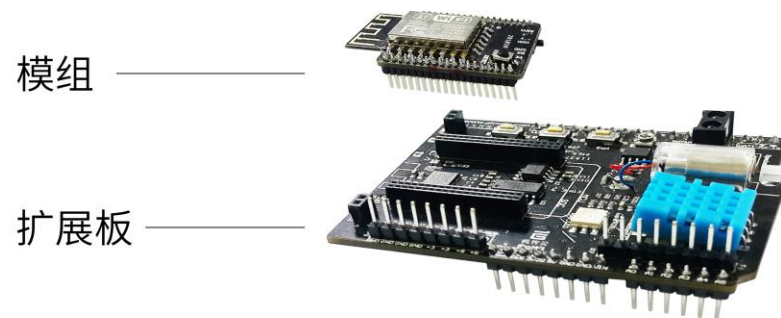
# GoKit3功能板



# MCU与SoC



## MCU方式



## SoC方式



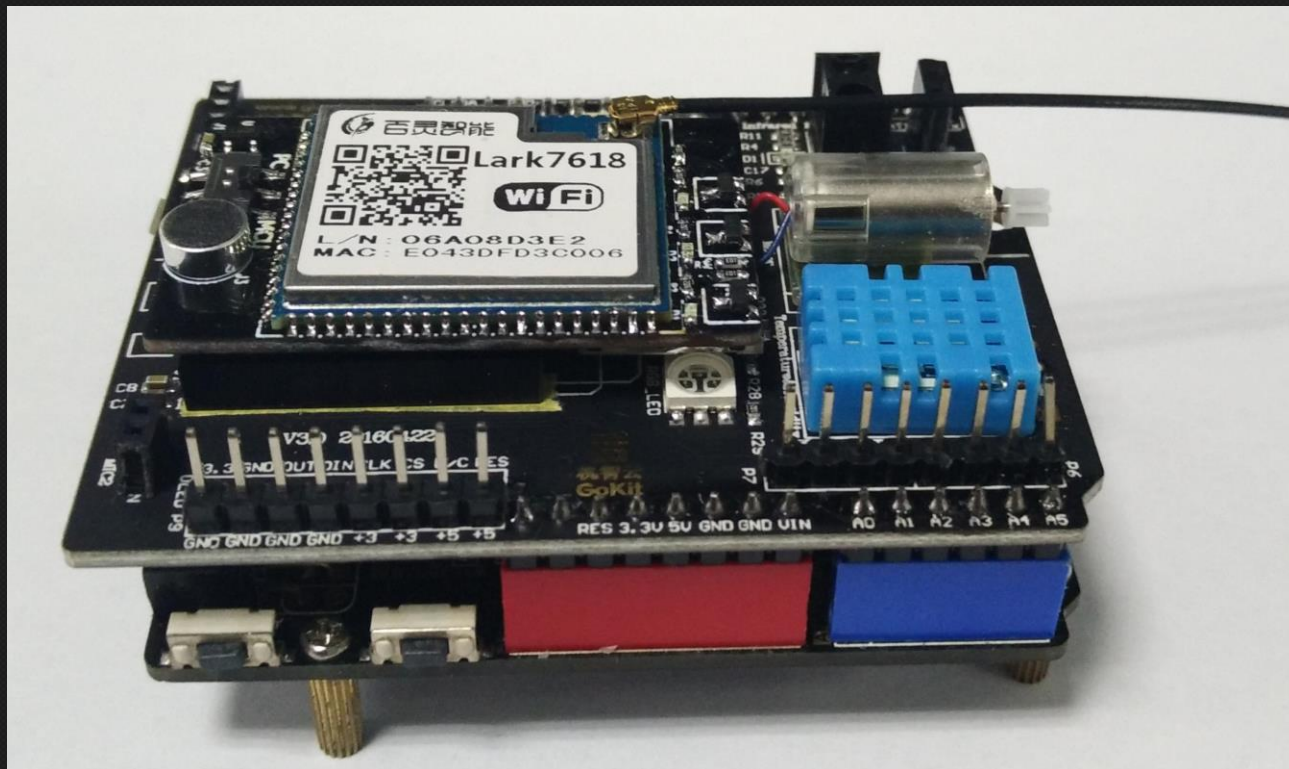
# GoKit3的三个版本

**GoKit3(V) - 语音模组版**

**GoKit3(S) - SoC版**

**GoKit3(H) - 高性能模组版**

# GoKit3(V) - 语音模组版



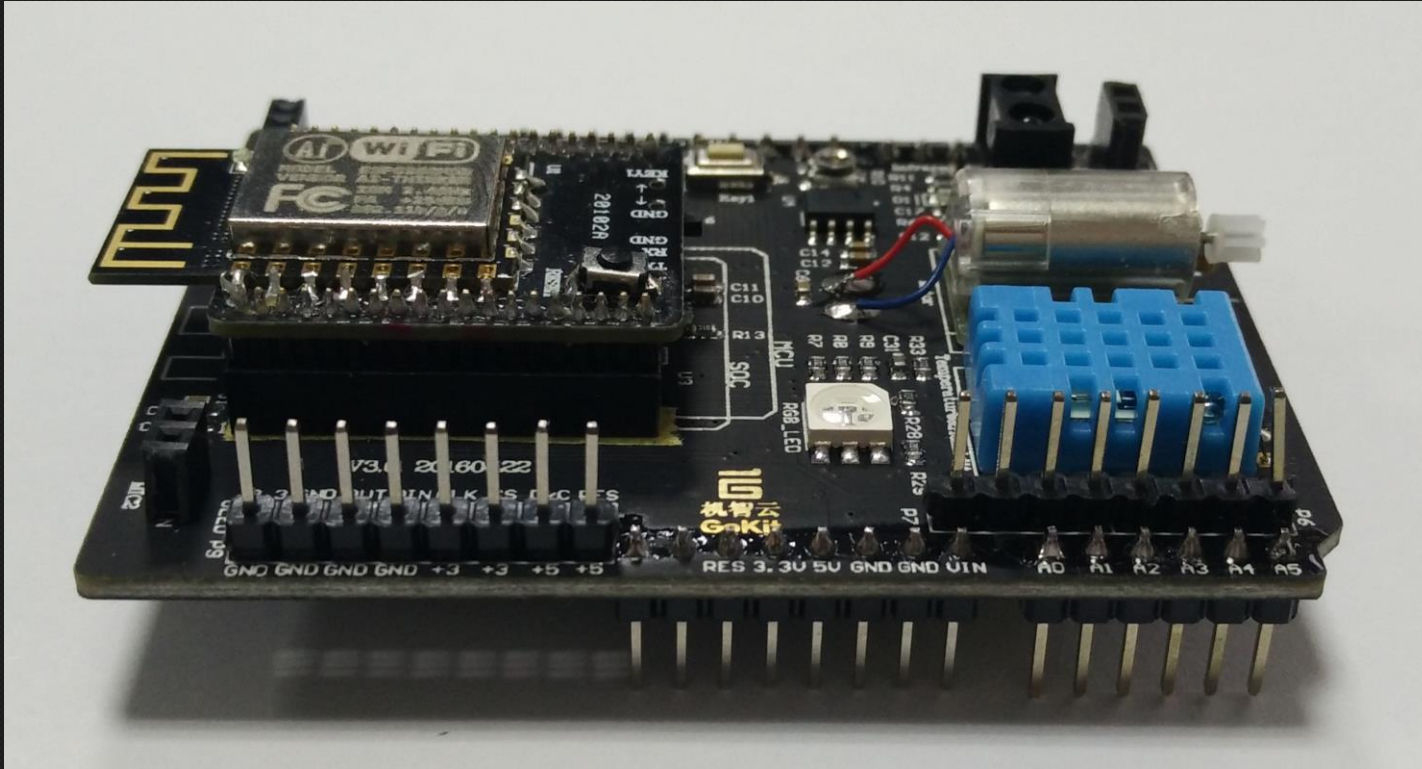
Lark7618语音模组

MCU连接方式

SoftAP和音波配置入网

数据点与词条绑定自定义

# GoKit3(S) - SoC版

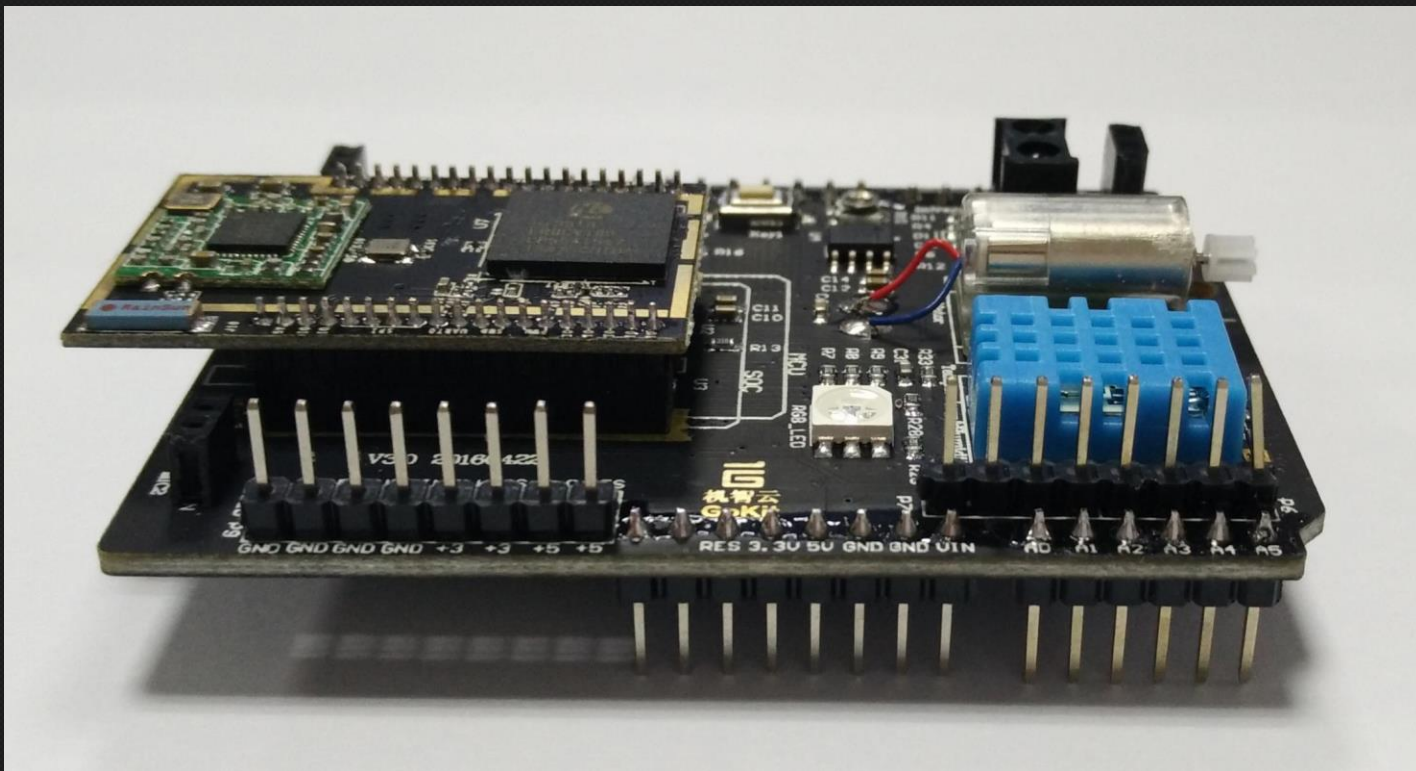


乐鑫模组(ESP-12F)

MCU/SoC连接方式

SoftAP和AirLink两种方式配置入网

# GoKit3(H) - 高性能模组版



高性能模组

580MHz主频, 64MB DDR, 16MB SPI Flash  
OpenWRT系统

MCU/SoC连接方式

可用于机器人\无人机\家庭网关等



# thanks

